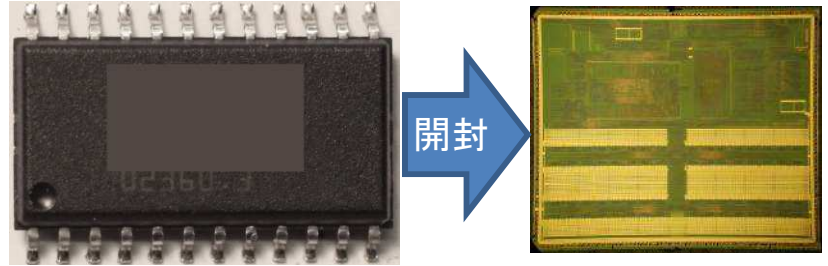


- ◆ 知的財産権調査
- ◆ 回路技術調査
- ◆ 回路規模・製造プロセス調査

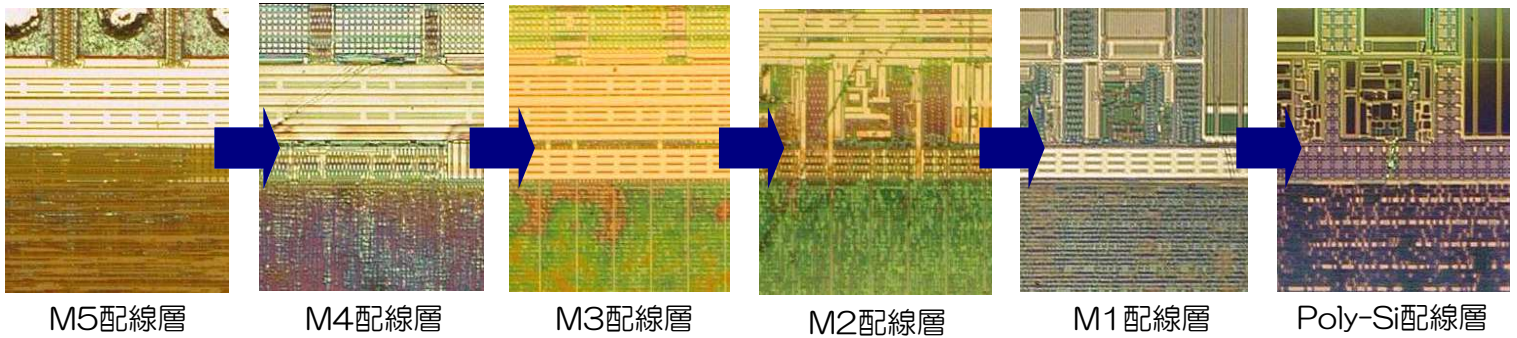
【1】前処理

■ ICパッケージ開封・観察（配線層数、材質）



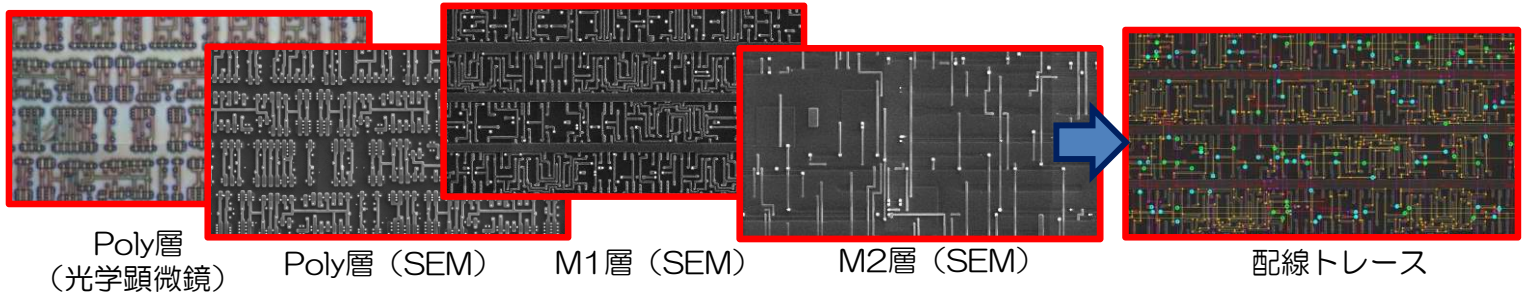
【2】各配線層露出・画像取得

■ 精密研磨・エッチング等により、配線層を1層ずつ剥がしながら、配線層を高解像度で撮影



【3】各配線層のトレース→ネットリスト生成

■ 各層の配線と層間接続ビアをトレースし、ネットリストを自動生成



【4】回路図作成

■ トレース結果（ネットリスト）を、
基にCADシステムで回路図作成

Cadence社形式でデータをご提供

